THine®

Interface to the Future
- Solution by Smart Connectivity -

ザインエレクトロニクス株式会社
2026年12月期
第3四半期決算説明資料

2026.11.05

中期経営戦略　2025-27

Innovate100



TODAY'S AGENDA

- 会社概要
- 2026年12月期3QTR業績概要
- 中期経営戦略「**Innovate100**」
- 当社グループ技術のご紹介

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.



TODAY'S AGENDA

- 会社概要
- 2026年12月期3QTR業績概要
- 中期経営戦略「Innovate100」
- 当社グループ技術のご紹介

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

会社概要

Interface to the Future
- Solution by Smart Connectivity -

“高速情報伝送の世界標準技術等、独自の価値を世界市場に提供”



- 社名　ザインエレクトロニクス株式会社
  （英名：THine Electronics, Inc.）
- 代表者　代表取締役会長　飯塚　哲哉
  代表取締役社長　南　洋一郎
- 創業理念　「人資豊燃」
- 資本金　11億7,526万円
- 創業　1991年5月（㈱ザイン・マイクロシステム研究所）
- 株式公開　2001年8月　東京証券取引所（スタンダード）
- 事業内容　ミックスドシグナルLSIの設計開発･製造･販売
  AI･IoTソリューション開発･提供、AI等データサーバー製品の
  企画･開発･製造･販売
- 従業員数　134名　（2026年9月末日現在、連結ベース）
  ※『健康経営優良法人2026』認定

JPX STANDARD TOKYO

2026 健康経営優良法人 KENKO Investment for Health 中小規模法人部門

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

事業拠点



韓国 - Korea -

ザインエレクトロニクスコリア
(THine Electronics Korea, Inc.)
韓国ソウル市　2010年3月設立

米国 –United States–

THine Solutions, Inc.
アメリカ合衆国 カリフォルニア州
2018年2月設立



中国 - China -

賽恩電子香港股份有限公司
(THine Electronics Hong Kong, Co., Ltd.)
2012年11月設立
哉英科技(深圳)有限公司
(THine Technology Shenzhen, Co., Ltd.)
2013年5月設立
同社上海分公司
2013年10月設立
深圳泰晨訊科技有限公司
(Shenzhen DynaCathay Communication Technology Co.,Ltd.)
2018年12月連結子会社化

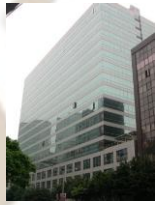


LSI 東京本社 - Tokyo -

東京都千代田区
1991年5月　創業

AIOT

ザイン・モバイルテック㈱
–Yokohama–
THine MobileTek, Inc.
神奈川県横浜市
2018年12月連結子会社化



台湾 - Taiwan -

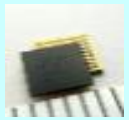
哉英電子股份有限公司
(THine Electronics Taiwan, Inc.)
台湾台北市　2000年9月設立

Server

ザイン･ハイパーデータ㈱
–Yokohama–
THine HyperData, Inc.
神奈川県横浜市
2024年6月設立

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

事業領域

	製品・ソリューション	適用アプリケーション例
LSI 事業	**<高速インターフェースLSI>** **V-by-One® HS plus** **V-by-One® HS** **LVDS** **Serial Transceiver IOHA:B** **光半導体（VCSELドライバ、TIA等）** **<カメラソリューション>** **Image Signal Processor** **Camera Development Kit**   	・事務機器（複合機（MFP）等）、アミューズメント機器 ・カメラ（車載カメラ、セキュリティカメラ、AR/VR、認証用カメラ、手術用カメラなど高精細カメラ） ・8K / 4Kなど高解像度映像機器、ゲーミング機器 ・ドライブレコーダ、EVなどの車載表示装置 ・モバイル・PC、シングルボードコンピュータ ・半導体・液晶ディスプレイ等検査装置 ・AI光コンピューティング（データセンター内の光ネットワーク）
AIOT 事業	**<通信モジュール>** **5G/LTE/NB-IoT** **<AI・IoTソリューション>** **IoTゲートウェイ/ルータ** **AI/IoTソリューション開発** **<AIサーバー>** **NVIDIA GPU搭載AIサーバー** **<データサーバー>** **General Server** **Smart NIC/Switch**   	<AI･IoTソリューション事業> ・通信機能付きドライブレコーダー ・AED（自動体外除細動器）遠隔監視 ・IPトランシーバー ・自動販売機、エレベーター遠隔監視装置、決済端末 ・見守りGPSトラッカー、地域見守りネットワークシステム ・スマートメーター、IoTスマートモジュール ・AI顔認証型体温検知システム、IoT温度監視システム <サーバー事業> ・ODM/OEMにより日本企業･AI等研究機関にAIサーバー･データサーバーを提供

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

事業領域



Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.



TODAY'S AGENDA

- 会社概要
- **2026年12月期3QTR業績概要**
- 中期経営戦略「Innovate100」
- 当社グループ技術のご紹介

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

’26年12月期3QTR業績のポイント①

▶ 連結業績概要（2026年3QTR）

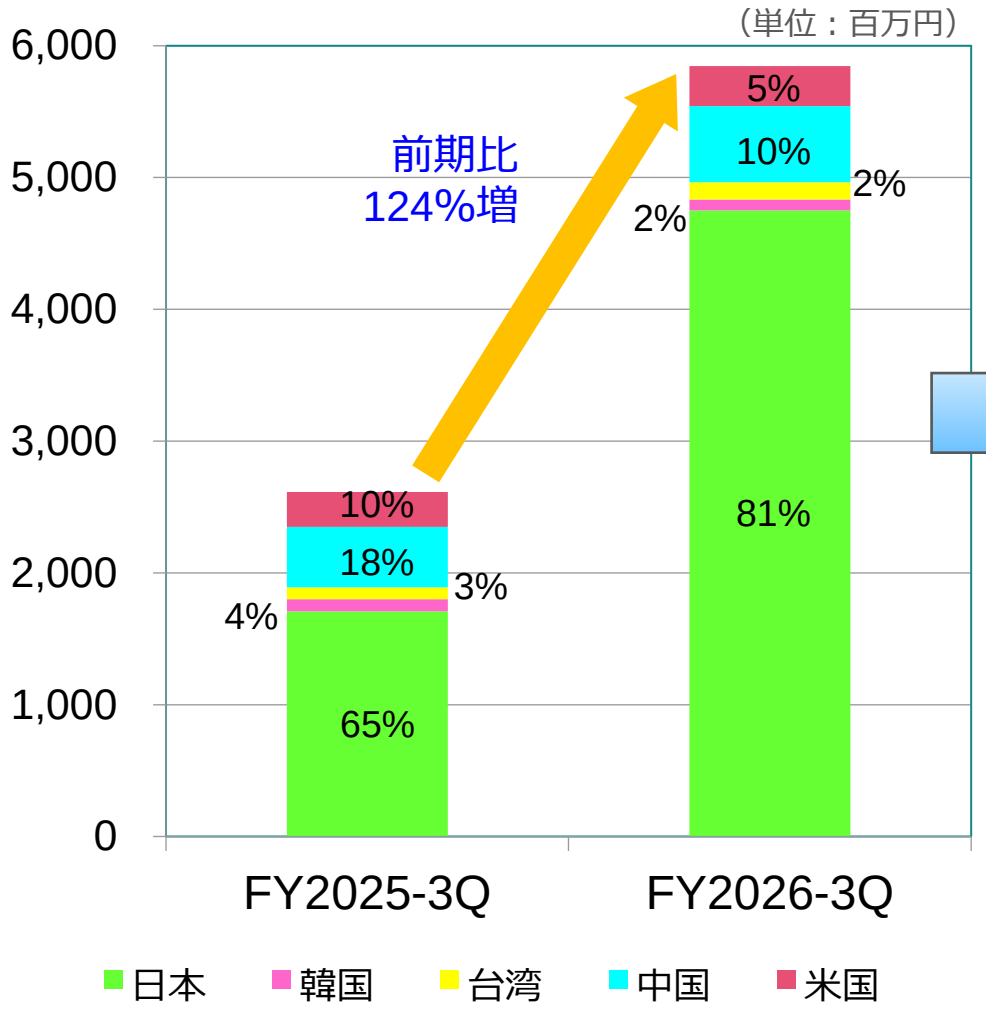
（百万円）

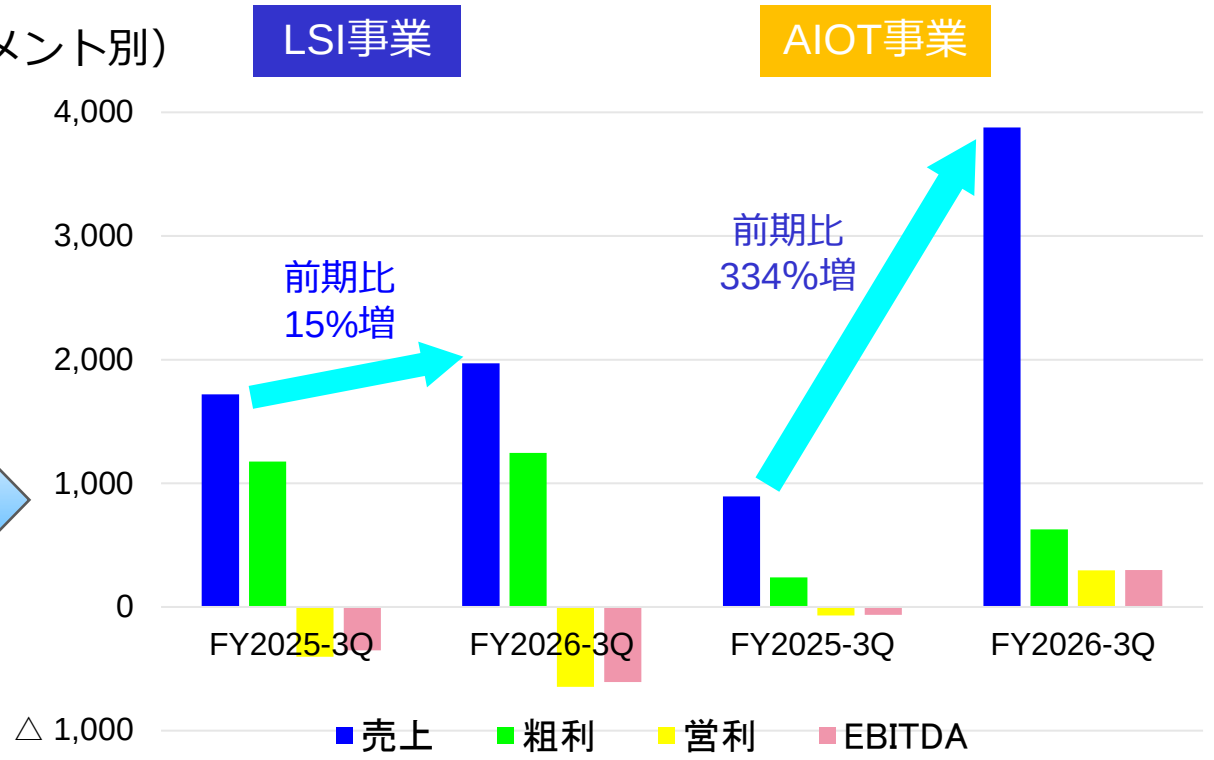
	2026年3QTR			2025年3QTR	
		構成比	前期比		構成比
売上高	5,845	100.0	223.7	2,613	100.0
売上総利益	1,872	32.0	132.5	1,414	54.1
販売管理費	2,224	38.0	118.0	1,884	72.1
（うち研究開発費）	1,229	21.0	132.0	932	35.7
営業利益	△351	△6.0	—	△470	△18.0
（EBITDA）	△306	△5.2	—	△415	△15.9
経常利益	△266	△4.6	—	△621	△23.8
参）経常利益（為替差損益を除く）	△262	△4.5	—	△466	△17.9
親会社株主に帰属する四半期純利益	△185	△3.2	—	△529	△20.3

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

’26年12月期3QTR業績のポイント②

▶ 2026年12月期3QTR売上分析（地域別・セグメント別）



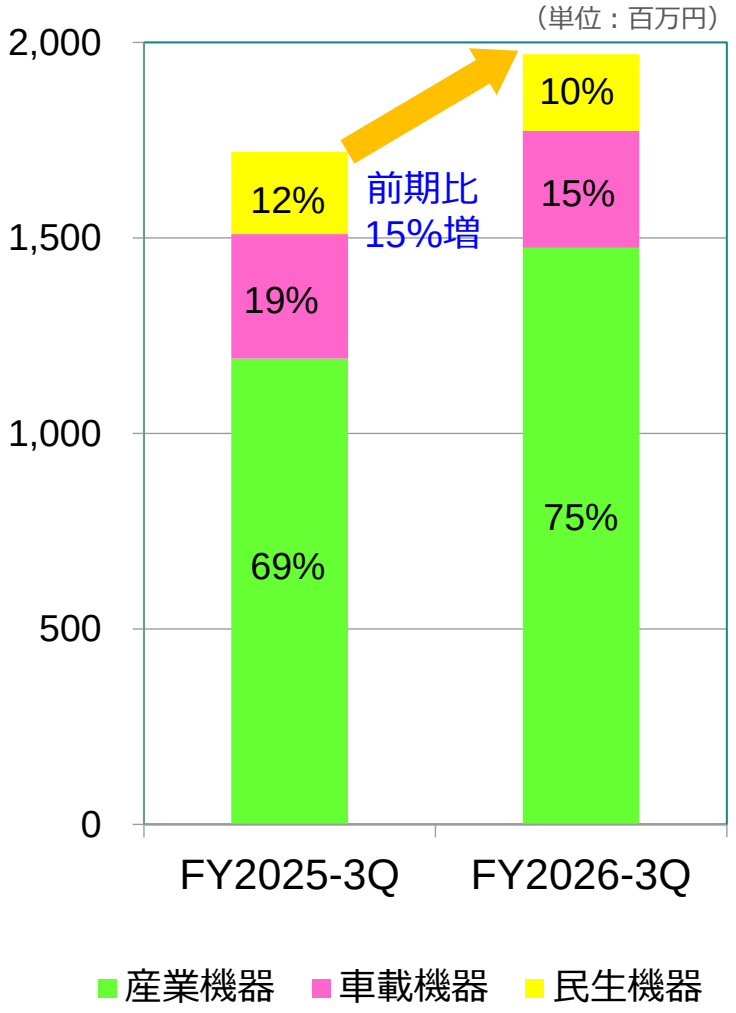


- LSIは国内市場はアミューズ向けの回復傾向もOA向け低調、海外市場は中国･米国向けが堅調、売上は前期比増加(+15%)。R&D費用は光半導体新製品等の開発を加速し積極投資（前期比＋32%）。
- AIOTは前期3Qより本格量産出荷を開始したスマートメーター向け製品の出荷が順調に増加、価格改定の影響もあり通信モジュール製品売上が大幅増加(+426%)。

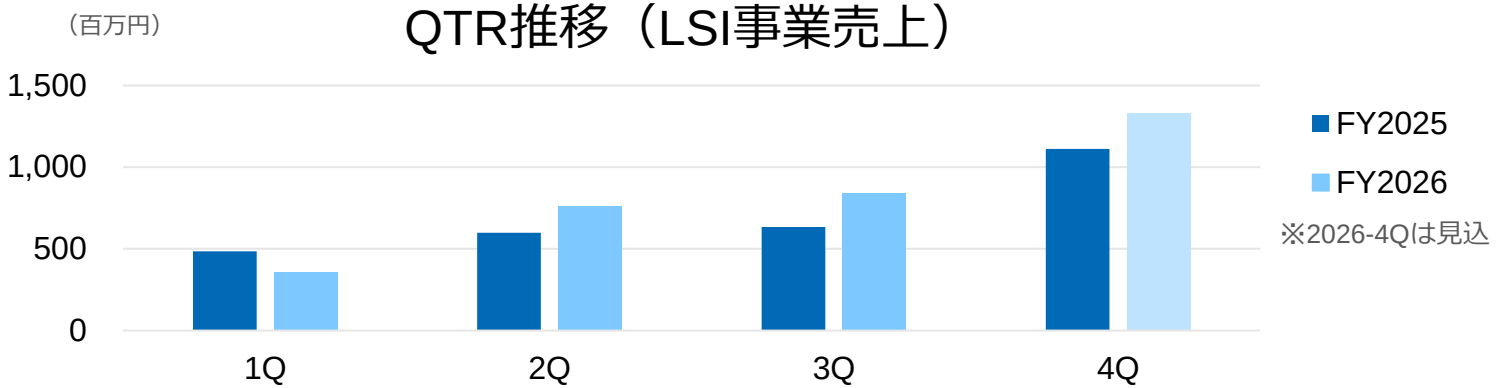
Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

’26年12月期3QTR業績のポイント③

▶LSI事業売上分析（アプリケーション・市場別）



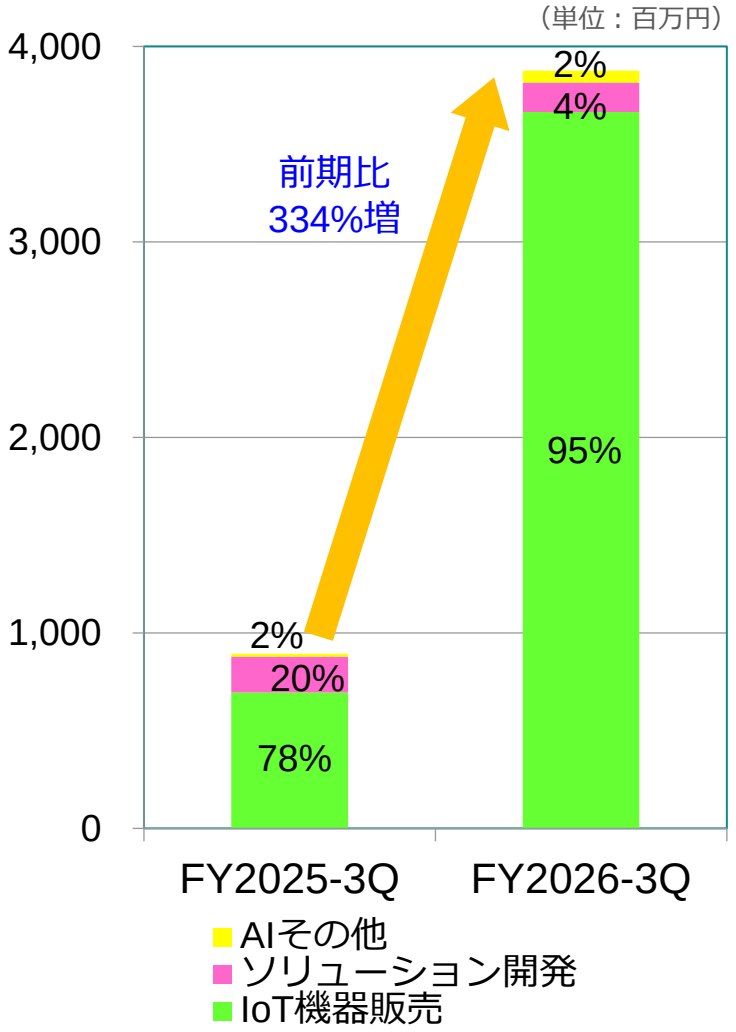
	要因分析
産機	売上全体の75%。前期需要回復したOA機器向けは概ね計画通りの進捗、、アミューズメント機器向けは在庫調整等の影響は回復傾向、産機全体では前期比増加(+24%)。OA機器向け(△14%)･アミューズメント機器向け(+159%)･その他産機向け(+41%)。
車載	売上全体の15%。前期比で減少(△6%)。米国市場向け(△11%)、中国市場向け(+2%)。EV向け新製品拡販を継続。
民生	売上全体の10%。前期比減(△7%)。4K/8Kテレビ等ディスプレイ向け情報伝送技術の当社新標準V-by-One®HS plusの提供は順調に進行。



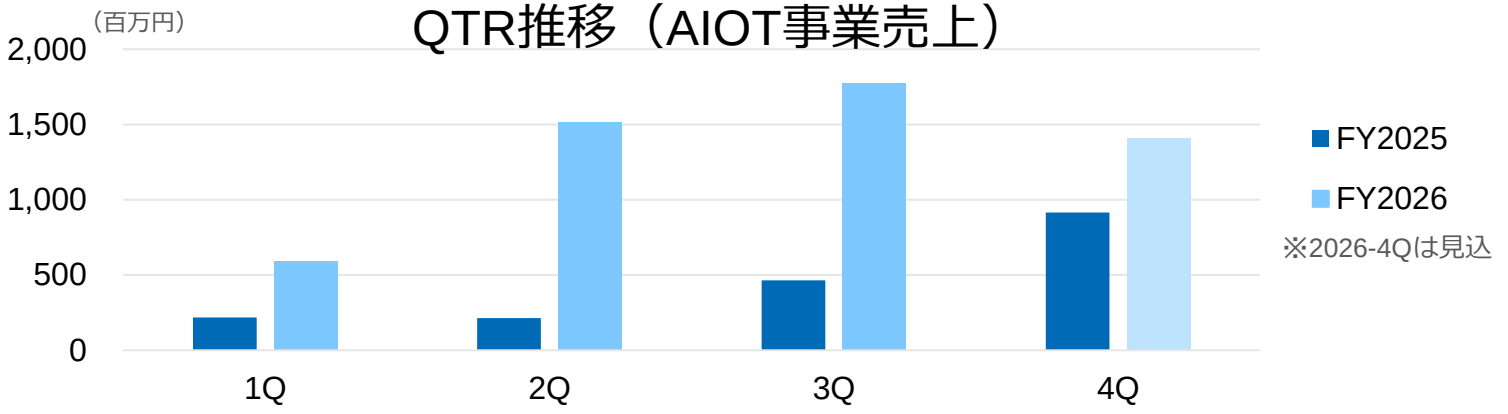
Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

’26年12月期3QTR業績のポイント④

▶AIOT事業売上分析（売上区分別）



要因分析	
IoT機器	売上全体の95%を占める。前期3QTRより本格量産出荷を開始したスマートメーター向け製品の出荷は順調増加。AED･エレベータ遠隔監視向け等の製品出荷も堅調で前期比大幅増加 (+426%)。
ソリューション開発	OEMルーター開発、監視カメラ組込用OEMルーター開発等のリピートオーダー等、前期比減少(△17%)。
その他	サーバー事業子会社については当社独資での事業展開に方針変更し拡販活動継続中。



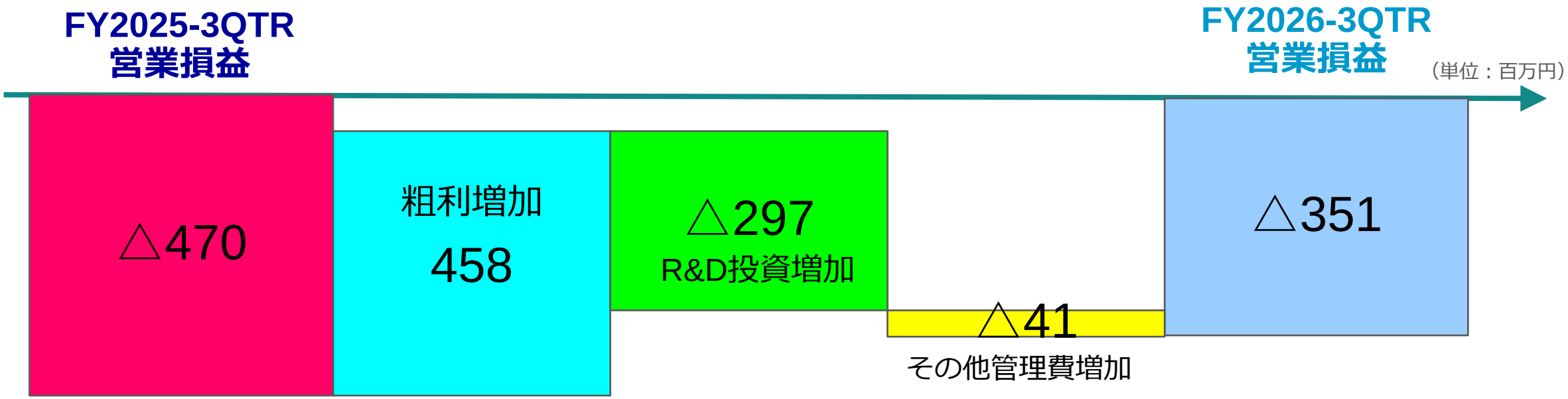
Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

’26年12月期3QTR業績のポイント⑤

▶ 営業損益変動内訳

- 前期比大幅増収(+124%)、増益(+33%)。事業ミックス割合の変化により粗利率は減少(54%→32%)。
- 新製品開発に向けたR&D積極投資を実施、前期比で大幅増加（同+32%）。
  AIデータセンター向け世界初DSPレス光半導体製品開発、EVパネルおよびカメラ向けV-by-One®HS
  新製品開発、新規電源製品開発、スマートIoTルーター開発、等にトータルで ¥1,229Mを効率的に投資。

※ 総務省より新たに採択されたBeyond5G無線通信用半導体技術開発を実施（費用は一部総務省負担）。
※ 光半導体開発はNICTの助成プログラムとして採択（3年間、令和7年度～8年度は6億22百万円の交付額）。

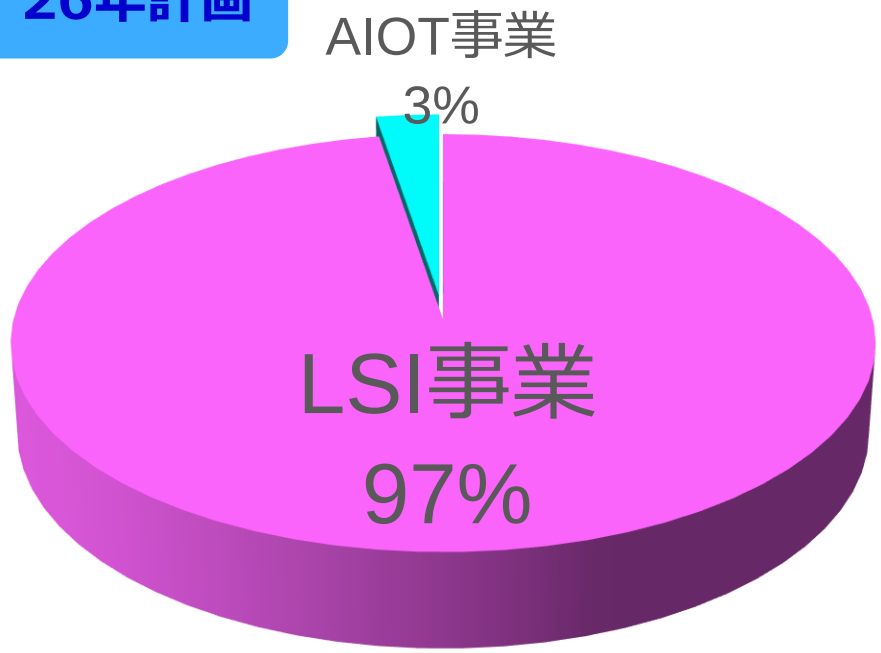


Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

’26年12月期3QTR業績のポイント⑥

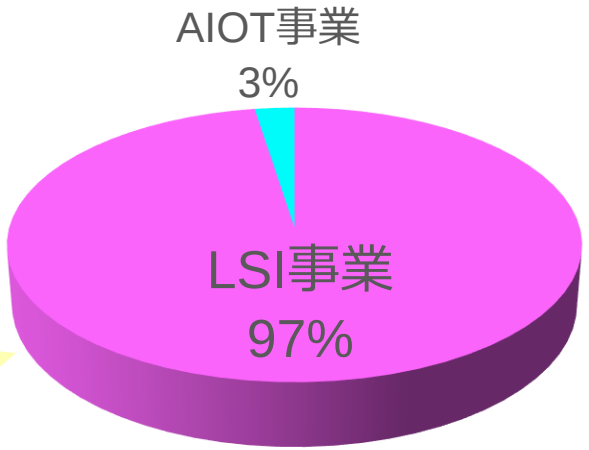
- 研究開発の状況
  - 中期経営戦略『Innovate100』の実現に向けて総額**16億65百万円**（前期比+26%）の投資を計画

’26年計画



FY2026-3Q実績

- **12億29百万円**の投資実施
  - 計画進捗率　74%
  - 前期比　132%



『Innovate100』重要技術開発

- AIデータセンター向け世界初DSPレス光半導体製品開発
- EVパネル･カメラ向け等V-by-One®HS製品
- 新規電源製品開発
- エッジAI処理用モジュール開発
- 音声通話機能付きゲートウェイ製品開発
- スマートIoTルーター開発
- スマートモジュール活用ソリューション開発
- スマート枕開発
- Beyond 5G無線通信用半導体技術開発、等

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

’26年12月期3QTR業績のポイント⑦

▶ 資産･負債及び純資産の概要（2026年9月末日）

（百万円）

資　産			負債純資産		
	’26-3QTR末	’25末		’26-3QTR末	’25末
現預金	7,397	6,454	買掛金	1,268	302
売掛金	1,246	1,482	その他流動負債	446	301
棚卸資産	1,096	934	固定負債	184	143
その他流動資産	321	250	株主資本	8,411	8,682
有形固定資産	158	135	その他包括利益累計額	166	53
無形固定資産	45	50	新株予約権	103	87
投資その他	426	357	非支配株主持分	111	93
資産合計	10,691	9,665	負債純資産合計	10,691	9,665

➢ ’26年3Q末保有の米ドル建現預金残高： 約US$16M

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

’26年12月期3QTR業績のポイント⑧

▶ キャッシュフローの概要（2026年3QTR）

（百万円）

	FY2026-3Q	FY2025-3Q
営業CF	887	△433
投資CF	174	201
財務CF	△112	△166
換算差額	△7	△116
期首残高	6,454	7,306
期末残高	7,397	6,791

- 税金等調整前純損失、売上債権減少、仕入債務増加、棚卸資産増加、等
- 投資有価証券売却、等
- 前期配当金支払い、等
- ¥156→¥157（2026-3Q末）

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.



TODAY'S AGENDA

- 会社概要
- 2026年12月期3QTR業績概要
- **中期経営戦略「Innovate100」**
- 当社グループ技術のご紹介

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

中期経営戦略「Innovate100」（2025-2027）

▶ 企業価値の向上に向けて

◆ **中期経営戦略「Innovate100」を策定し、目標年度2027年12月期において連結売上高100億円超を目指します。**

5G&Beyond-NE
（2022－2024）

Innovate100
（2025－2027）

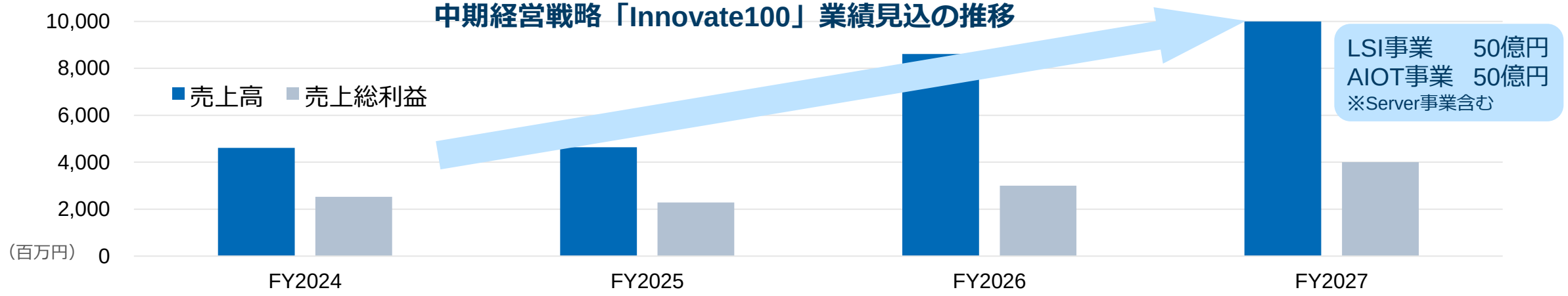
2027年12月期連結売上高 100億円以上

上記目標達成時

ROIC（投下資本利益率）10%以上達成見込

※ROIC＝（営業利益×(1-実効税率)）÷（株主資本＋有利子負債）

中期経営戦略「Innovate100」業績見込の推移



Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

中期経営戦略「Innovate100」（2025-2027）

▶ 中期経営戦略「Innovate100」の概要

◆ 基本戦略

THineグループ3事業（LSI/AIOT/Server）を通じてAI社会実装の加速と共に、光半導体等を通じてデーターセンター消費電力の拡大抑制に貢献していく方針です。
また、コラボレーションやアライアンスを一層重視し、M&Aやパートナー企業とのwin-win協業の機会をさらに強力に模索して参ります。

◆ 具体的な取り組み

- AIプロセッサー搭載ソリューション事業立上げ
- DX-IoT向け有線･無線ソリューションの適用拡大
- カスタム型LSI事業の顧客拡充
- AIデータセンター向け光半導体
- インフラ向けセンシング･ソリューション事業立上げ
- スマートメーターを起点とする社会インフラに向けた無線通信技術展開
- AIセンシング等によるスマートライフ関連事業展開
- AIサーバー等、サーバー事業の拡販加速



Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

中期経営戦略「Innovate100」（2025-2027）

▶ 2026年12月期通期業績見通し

中期経営戦略『Innovate100』進行中。目標年次（2027年度）において売上高100億超の実現を目指します。
2年目の2026年12月期は下記の業績見通しであります。
※ **2026年2月5日及び7月21日に開示した見通しについて売上高について見通しを修正しております**。

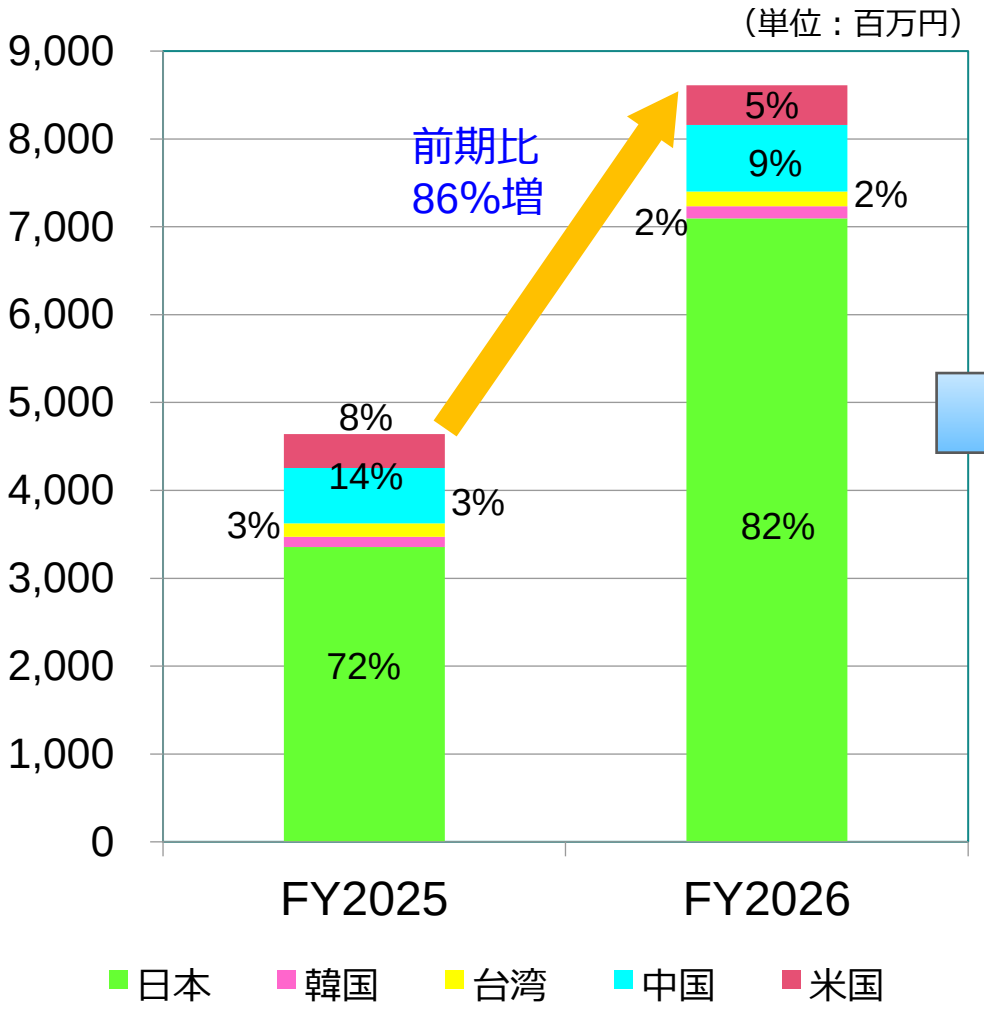
（百万円）

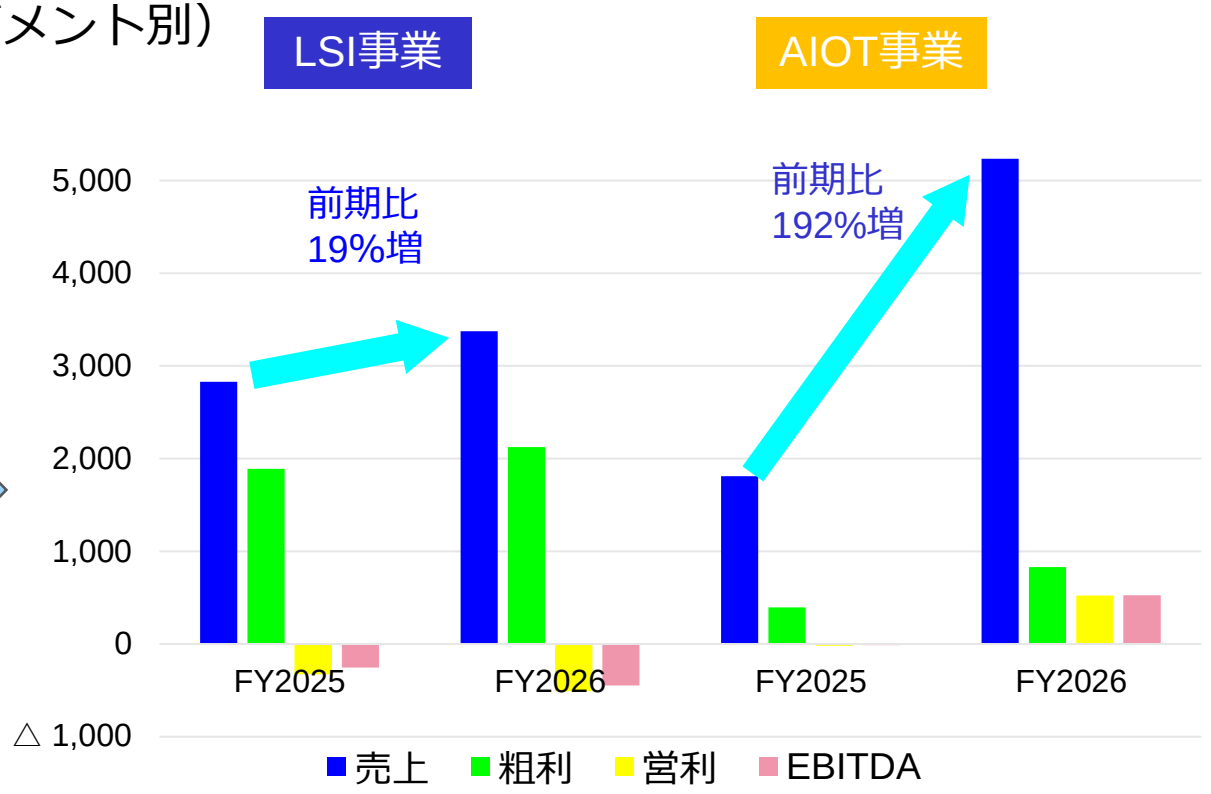
	2026年度通期見通し				2026年度計画		2025年度実績		2024年実績	
		構成比	増減率	前期比		構成比		構成比		構成比
売上高	**8,609**	**100.0**	**128.6**	**185.6**	**6,695**	**100.0**	**4,639**	**100.0**	**4,614**	**100.0**
売上総利益	**3,005**	**44.9**	**—**	**131.5**	**3,005**	**44.9**	**2,285**	**49.3**	**2,528**	**54.8**
販売管理費	2,992	44.7	—	113.8	2,992	44.7	2,628	56.7	2,500	54.2
（うち研究開発費）	1,665	24.9	—	126.0	1,665	24.9	1,321	28.5	1,154	25.0
営業利益	**13**	**0.2**	**—**	**—**	**13**	**0.2**	**△342**	**△7.4**	**28**	**0.6**
EBITDA	84	1.3	—	—	84	1.3	△268	△5.8	125	2.7
経常利益	**85**	**1.3**	—	—	**85**	1.3	△403	△8.7	264	5.7
親会社株主に帰属する当期純利益	**107**	**1.6**	**—**	**—**	**107**	1.6	△334	△7.2	339	7.4

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

中期経営戦略「Innovate100」（2025-2027）

▶ 2026年12月期通期業績見通し（地域別・セグメント別）





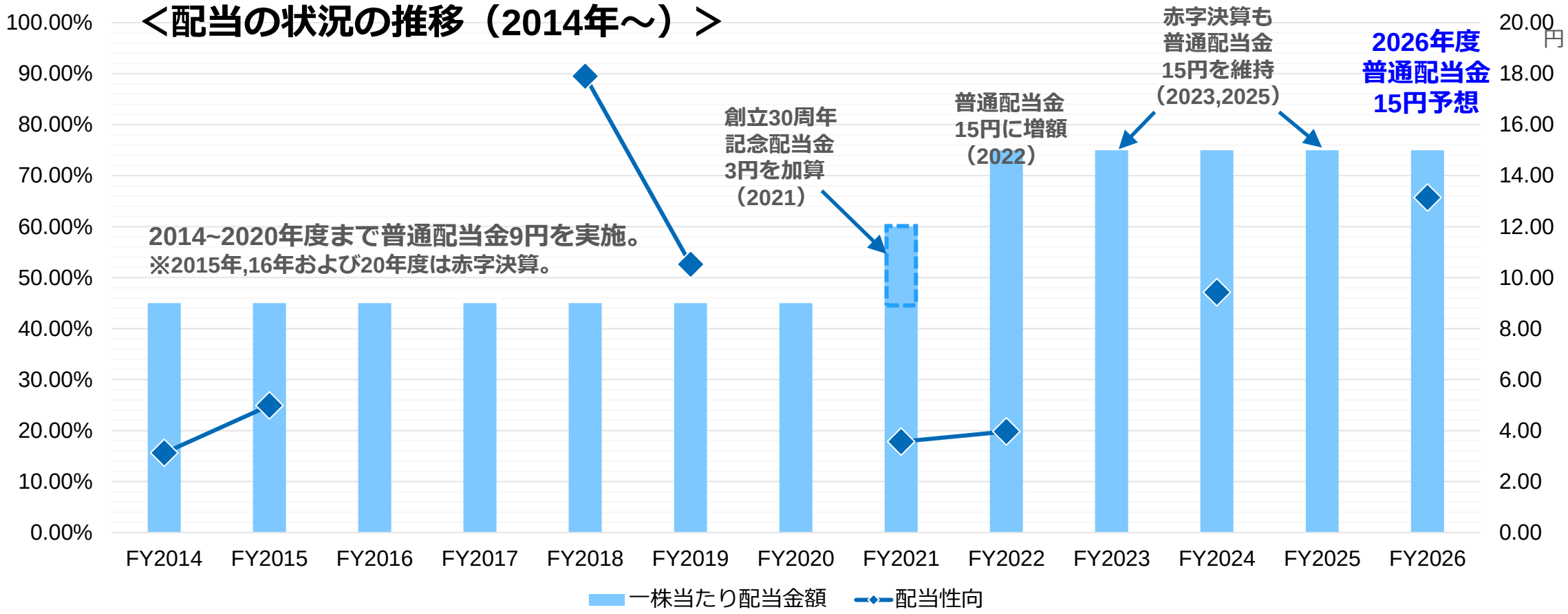
- LSI事業はOA機器市場向けはやや低調もアミューズメント市場向けが回復し前期比増加、海外市場向けも中国･米国市場向けを中心に車載･産機市場向け等で増加し前期比増収の見込み。
- AIOT事業は前期下半期より本格化したスマートメーター向け製品の量産出荷が順調に推移し、売上の大幅増加に貢献。

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

中期経営戦略「Innovate100」（2025-2027）

▶ 株主の皆様への還元方針

中期経営戦略「Innovate100」の実現に向けて取り組み、今後の成長を踏まえて株主の皆様への還元を実施して参ります。**2026年12月期の期末配当については1株当たり15円を予定**しております。



Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.



TODAY'S AGENDA

- 会社概要
- 2026年12月期3QTR業績概要
- 中期経営戦略「Innovate100」
- 当社グループ技術のご紹介

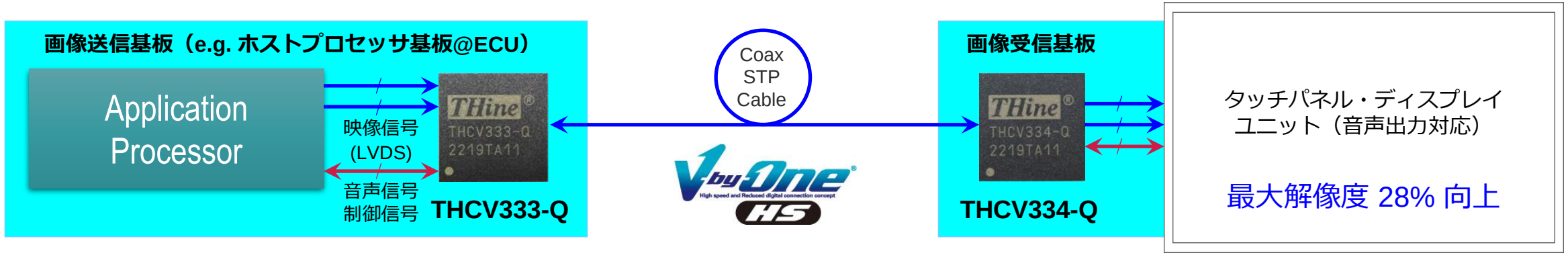
Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介①

▶ 車室空間のユーザー体験を拡げる：タッチパネル向け省配線ソリューション

車載・産機組み込みパネル向けV-by-One®HS技術応用 新製品出荷開始

- フルHD60fps超の映像・タッチパネル制御・音声信号を1チップのみで送受信可能
- 車載業界における従来他社代表製品と比べて最大データ伝送量およそ28%向上　Open LDI(LVDS)対応SerDesとして業界最速クラス





①車載用組込タッチパネル

- インフォメーションディスプレイ
- リアシートエンターテイメント
- カーナビゲーション
- ディスプレイオーディオ



②産業用組込タッチパネル

- HMI/プログラマブル表示機
- タッチパネル自動販売機
- エレベータ筐体内パネル
- 交通系モニタ

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

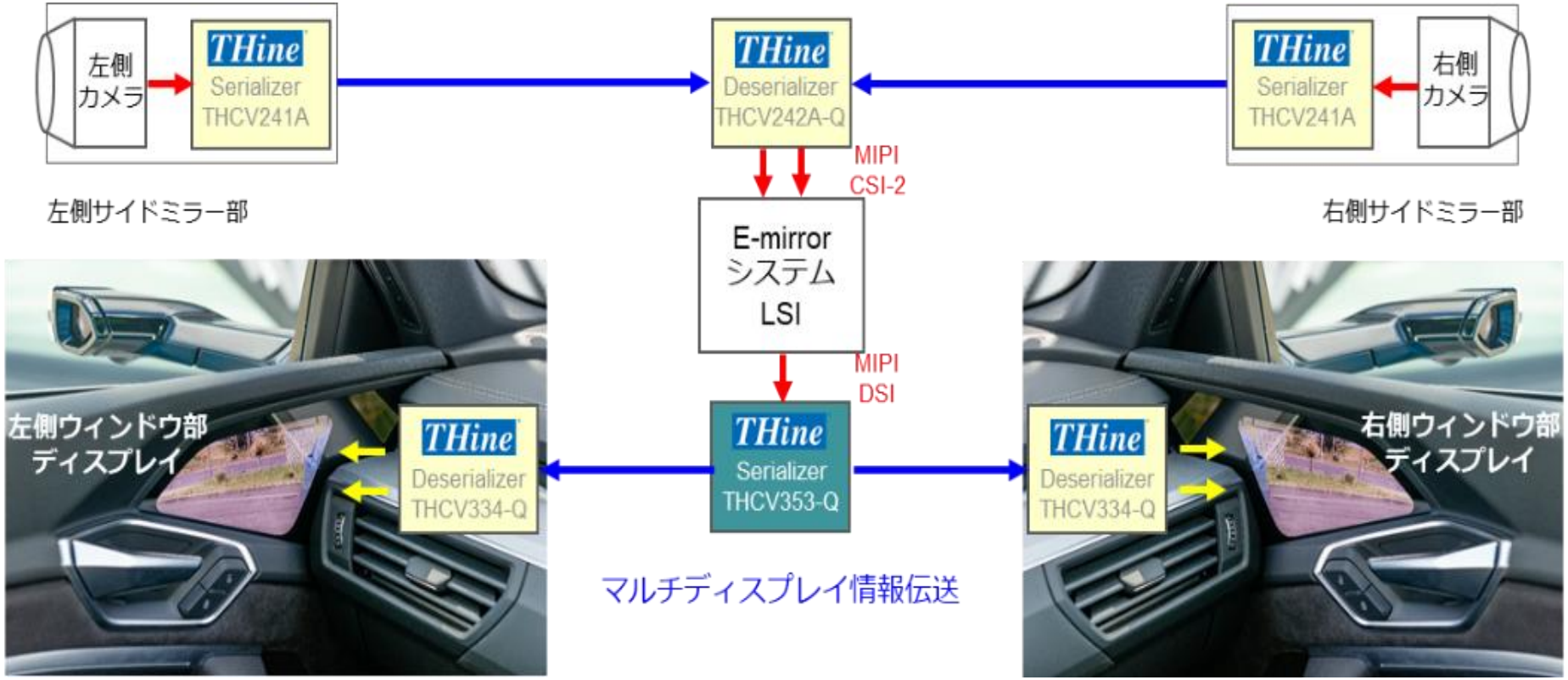
THine Interface to the Future - Solution by Smart Connectivity -

当社グループ技術のご紹介②

▶ 車室空間のユーザー体験を拡げる：マルチディスプレイ向けソリューション

車載・産機組み込みパネル向けV-by-One®HS技術応用 新製品出荷開始

- 簡素な車載システムにより、左右サイドミラー部のカメラ映像を左右ウィンドウ部のディスプレイに出力可
- 優れたタッチパネル応答性能を実現、音声データも動画像データと合わせて同じケーブルで伝送可



Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介③

▶ 医療用カメラの革新に貢献

医療用カメラ対応ソリューションの拡販

- 高解像度**４K内視鏡カメラ**の実現に貢献
- 超小型V-by-One® HS製品によりシステム操作部までの数メートルにわたりケーブル1本で伝送可能
- 画像処理用LSI併用も可能
- 顧客側AI機械学習により、フルHD内視鏡カメラ、ハイビジョン内視鏡カメラに比較して、早期癌の識別に貢献



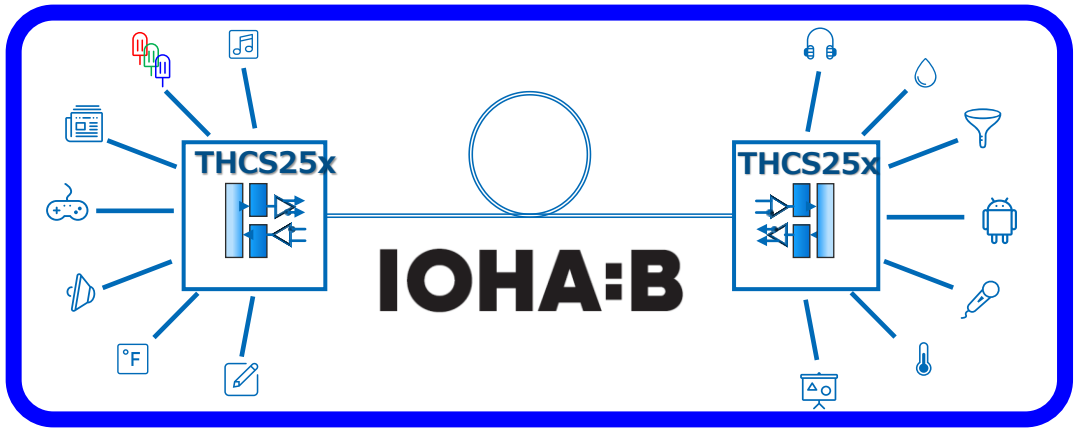
Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介④

THine Interface to the Future - Solution by Smart Connectivity -

▶ DX-IoTセンサー信号統合ソリューションに貢献

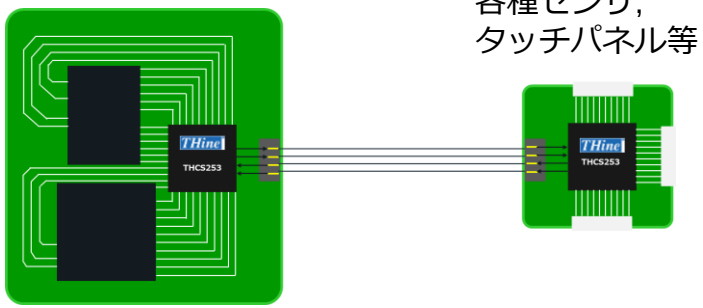
IOHA:B シリアル・トランシーバ新製品を量産開始

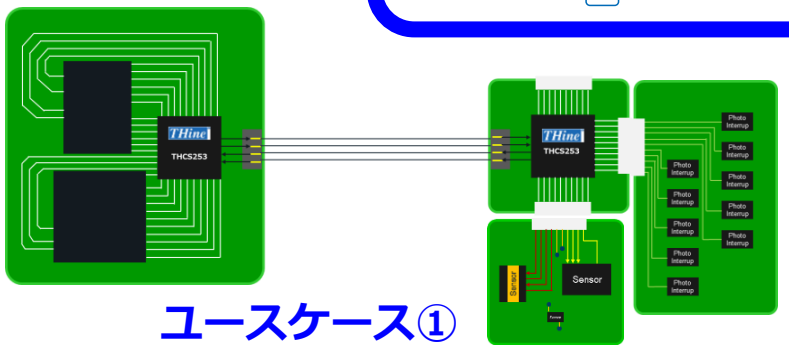


DX-IoT Platform with THine

システム本体基板

個別機能基板:
各種センサ,
タッチパネル等

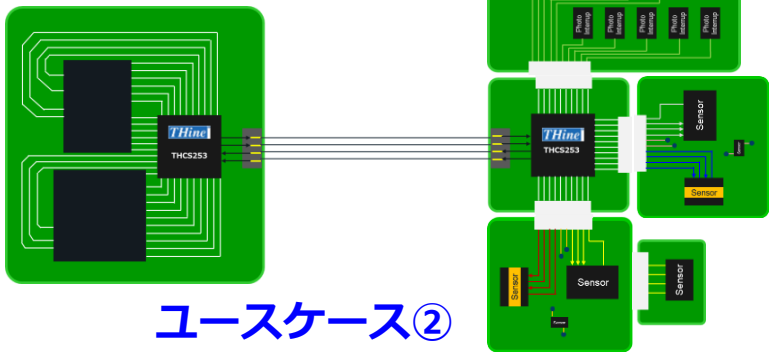




ユースケース①

カメラセンサ、加速度センサを接続

回路設計も変更も不要



ユースケース②

上記のカメラセンサの接続位置を変更し、加速度センサを外し、圧力・温度センサとパネル用タッチセンサを接続

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介⑤

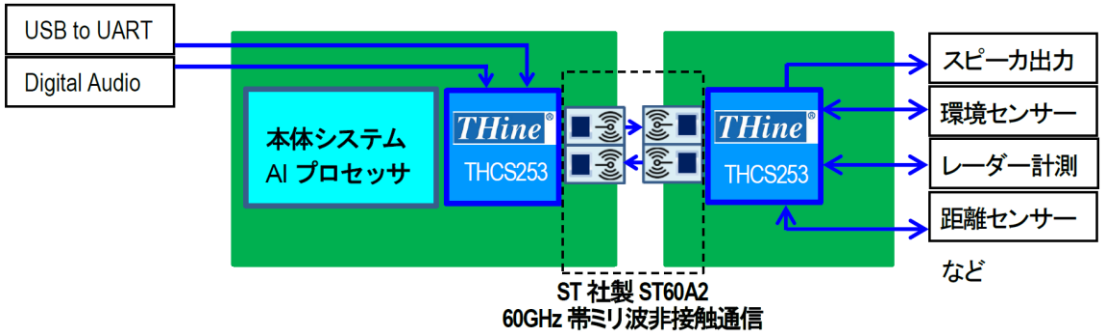
THine Interface to the Future - Solution by Smart Connectivity -

▶ 非接触データ通信のユースケース進化への貢献

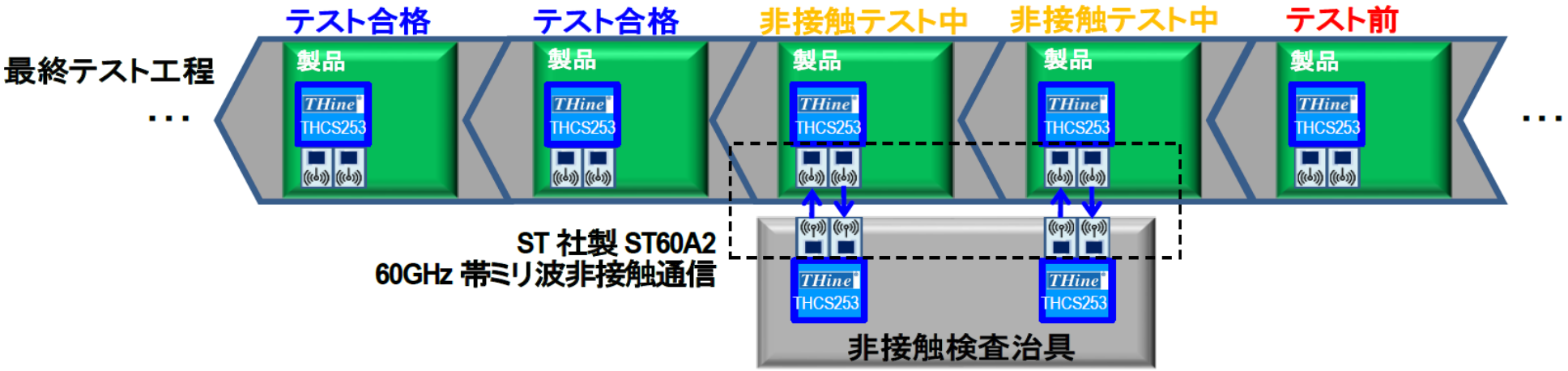
STマイクロエレクトロニクス社（ST社）の高速近接無線技術とのコラボレーション

➢ 当社の高速情報伝送技術とST社の60GHz帯ミリ波を使用する高速近接無線技術と組み合わせることにより新たな高速伝送アプリケーションの進化をサポート

基板対基板の非接触接続やコネクタ不要のソリューション等の新しいユースケースの実現が可能に。



無配線・無コネクタによるシームレスなデバイス接続ソリューションのイメージ



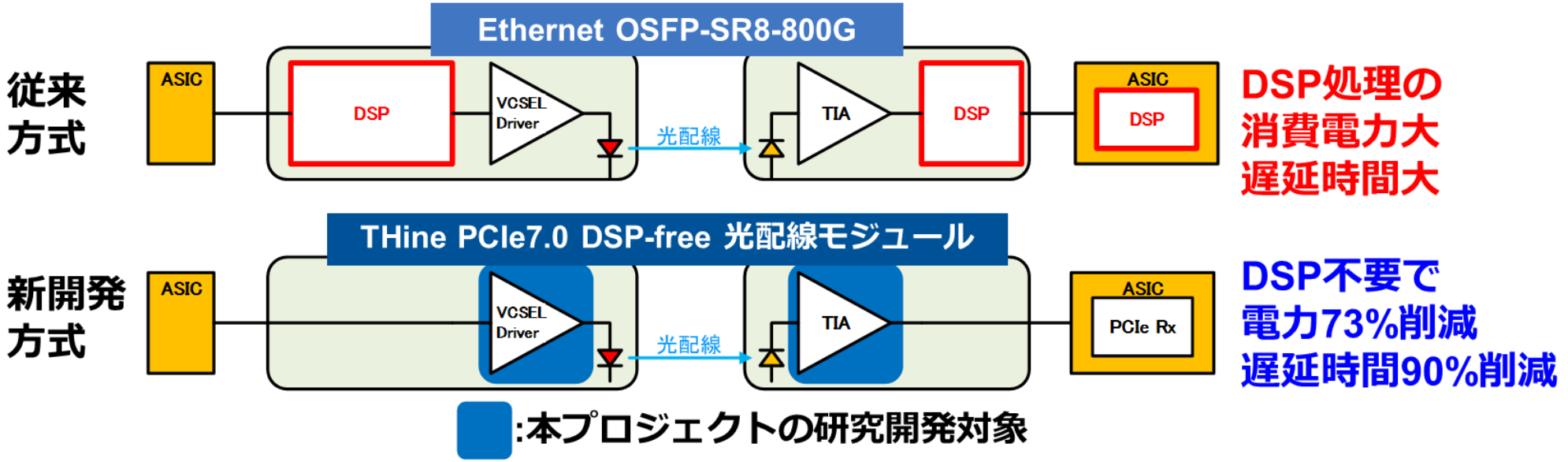
Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介⑥

▶ 生成AIで拡大するAIデータセンター消費電力削減等への貢献

世界初 VCSEL対応デジタルシグナルプロセッサ不要（DSPレス）の光半導体を開発

- 次世代PCIe Gen6.0(1TB/s光通信)、次々世代PCIe Gen7.0(2TB/s光通信) 対応、**世界のAI光コンピューティング実現に貢献**
- データ送受信の**電力73%削減**、**遅延時間90%削減**、**AI処理速度向上**が期待される



政府のBeyond5G(6G)基金の研究開発プロジェクト(３年間)※に採択

※ 国立研究開発法人 情報通信研究機構 革新的情報通信技術基金 事業社会実装・海外展開志向型戦略的プログラム［事業戦略支援型］
当初2年度(2025年度、2026年度)に**6.2**億円の研究開発費を助成

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介⑥

- 生成AIで拡大するAIデータセンター消費電力削減等への貢献

欧州最大の光通信技術展(ECOC2026)※にDSPレス光半導体2製品(THLD6481/THTA6482)を出展

※ European Conference on Optical Communications 2026

- ECOC2026(開催地: スペイン)に、AIサーバー能力大規模化に際して超低遅延・低消費電力・高密度化・低コスト化の全てを可能とするDSPレス光半導体2製品(VCSEL Driver: THLD6481、TIA: THTA6482)を出展し、高い関心を獲得するとともに、重要顧客とも交流。







Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介⑦

- Society 5.0実現に向け、Beyond 5G（サブテラヘルツ帯活用）への貢献

総務省委託（2026年度～2029年度）による、多数同時・大容量通信技術の研究開発

275GHz帯中距離大容量無線通信技術の研究開発におけるチップ間同期対応ベースバンドの開発

国立研究開発法人
情報通信研究機構

THine

Ministry of Internal Affairs and Communications
総務省

京セラ株式会社

コネクテックジャパン株式会社

国立大学法人
広島大学

国立大学法人
名古屋工業大学

学校法人
東京理科大学

総務省基本計画が想定する275GHz帯活用ユースケース

- データセンタでのサーバー筐体間データ伝送の無線化
- 工場内機器（自動工作機・検査機・輸送機等）の無線接続
- 運輸業車両等無線通信、等

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

THine® Interface to the Future - Solution by Smart Connectivity -

当社グループ技術のご紹介⑧

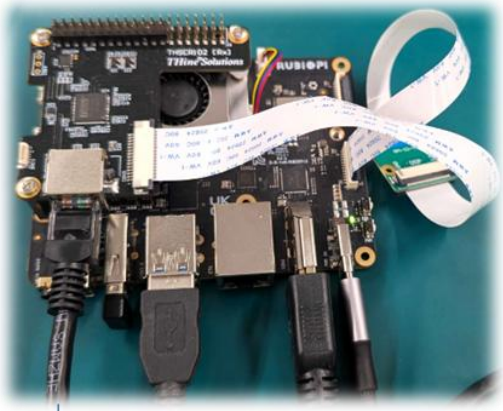
▶ 情報伝送技術の価値によりスマートに「つなぐ」＋スマートに「判断する」

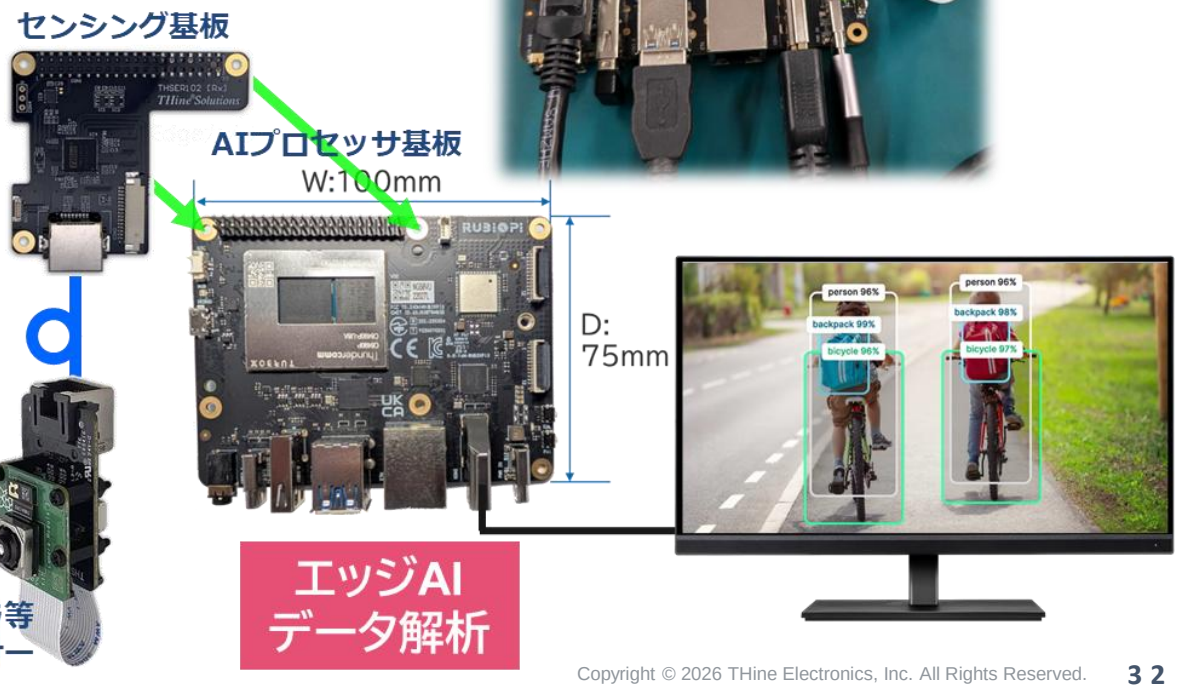
EdgeAI-Link®ワンストップ・ソリューション (クラウド連携可能エッジAIソリューション)

シングルボードコンピュータ Raspberry Piサイズで
エッジAI開発を簡単に! 必要な分だけクラウド連携。

- AI診断のリアルタイム性を確保
- AI精度と通信コスト削減を両立
- プライバシー秘匿性を維持
  （AI結果のみ通信）
- 12 / 48 / 100TOPS対応ロードマップ

※EdgeAI-Link® はザインエレクトロニクスの登録商標です。





用途

- 属性認識・顔認証
- 店舗マーケティング
- ドライブレコーダ
- 防犯・防災　等

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介⑨

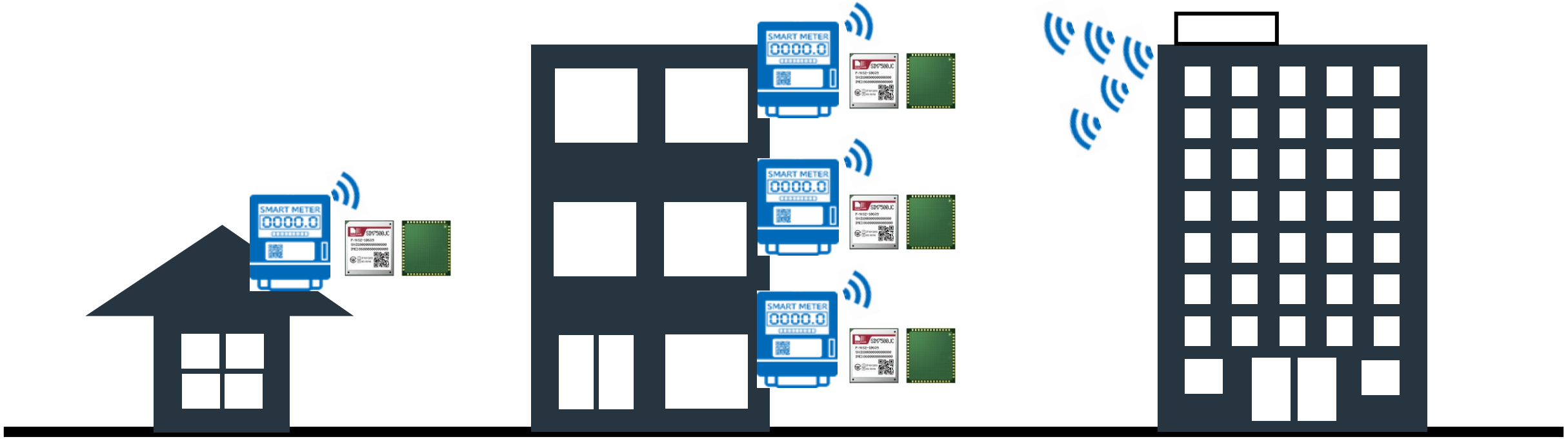
THine Interface to the Future - Solution by Smart Connectivity -

▸スマートメーター普及活用への貢献

スマートメーター用無線通信モジュールによる機能充実

- 遠隔メーター情報を無線で常時送信する機能
- メンテナンス機能（セキュリティ機能強化を含む）を充実など
- お客様ご要請機能をカスタム開発、ファームウェア搭載提供、充実したお客様サポートを提供

※ **遠隔データ送信に加えて、使用量の見える化も可能 → データ活用による新しい価値の創出**



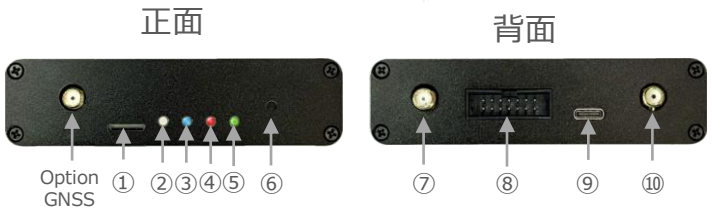
Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介⑩

▶ 各種機器のIoT接続への貢献

LTE/BLE Gateway CTG-B12





項 目			備考
	SIM コネクタ	①	nano-SIM用
正面 インジケータ	電源	②	白色
	LTE通信	③	青色
	アラーム	④	赤色
	BLE通信	⑤	緑色
	リセットボタン	⑥	
背面 コネクタ	BLE通信用アンテナコネクタ	⑦	SMAタイプ
	APPソフトウェアコネクタ	⑧	SWDインターフェース（カバープレート内）
	USB Type-C コネクタ	⑨	給電および通信設定用
	LTE通信用コネクタ	⑩	SMAタイプ

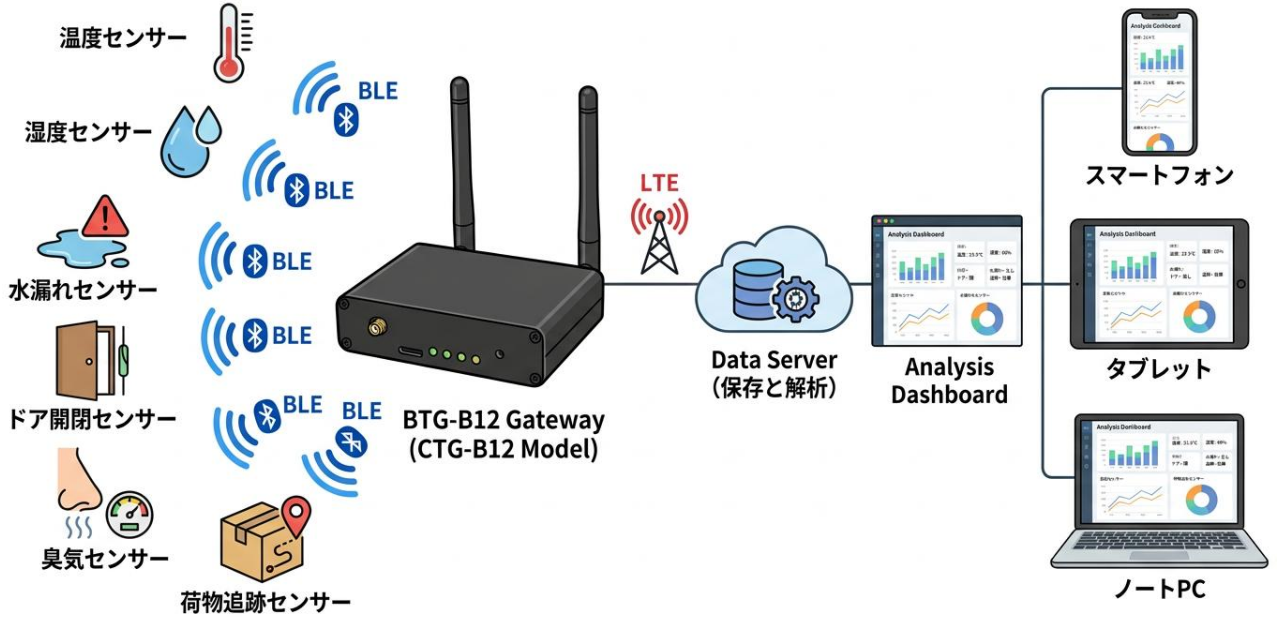
■ 製品概要

CTG-B12は各種BLEセンサー機器のデータを収集し、LTE回線にてデータ送信可能なBLE/LTEゲートウェイ。
Cat.1bisのLTE回線に対応しています。

ロングレンジにも対応しているBLE通信とLTE通信にそれぞれ専用のアンテナを備え通信性能を重視。
BLE通信用のSoCとしてNordic社のnRF54L15を使用しており同社が提供する開発環境を利用し
各種BLEセンサーに対応するカスタムアプリケーションの開発が可能。

GNSSレシーバー機能も工場生産オプションにて対応。

BTG-B12を用いたIoTエコシステム（BLEセンサーデータ収集・解析図）



Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介⑫

▶ 各種機器のIoT接続への貢献

RS485/産業用LTEルーター TM-RT01



■特徴

ノーコードで機能設定をプログラムできる各種ソフトウェアを組み込み可能なプラットフォーム構成のため、設定と検証が直ぐにできるのでカスタマイズが簡単にできます。

- LTE対応産業用シリアルゲートウェイ
- NXP I.MX 8M mini QuadLite SoC
- SIMCom SIM7600JC-HG Cat4 LTE PCIEモジュール搭載
- RS485インターフェース
- 4つのDIDOポート(2系統)
- SIMカードおよびeSIM対応

■ 製品概要

ゲートウェイ機能を充実させたCat.4 LTEルーター

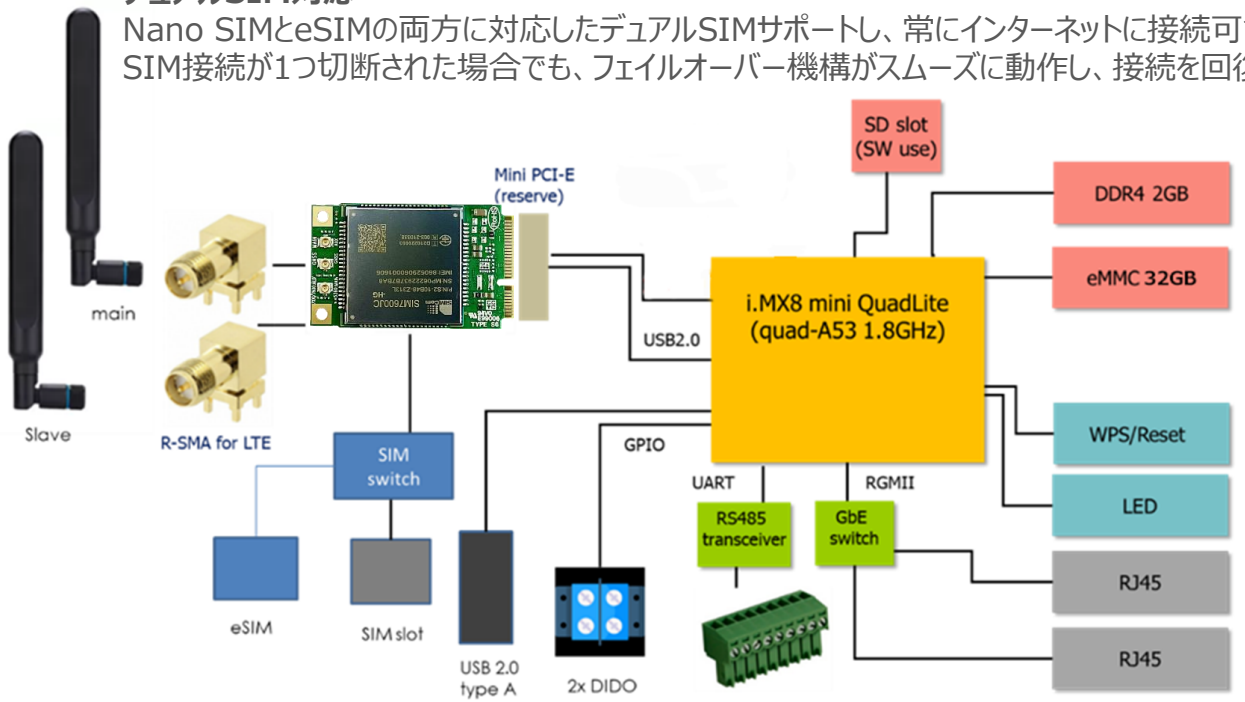
TM-RT01は、下り最大150Mbps、上り最大50Mbpsの通信速度に対応した LTE Cat.4 対応のSIMCom SIM7600JC-HG-PCIEを搭載したデバイス。 SIMスロットとeSIMの両方を利用可能。

RS-485およびDIDO

TM-RT01は産業用アプリケーションに最適。
RS485シリアルインターフェース（半二重および全二重構成可能）とDIDO出力をサポート。
工場の機械や信号機の制御も実行できる非常に多用途に利用可能なデバイス。

デュアルSIM対応

Nano SIMとeSIMの両方に対応したデュアルSIMサポートし、常にインターネットに接続可能。
SIM接続が1つ切断された場合でも、フェイルオーバー機構がスムーズに動作し、接続を回復。



Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介⑬

THine Interface to the Future - Solution by Smart Connectivity -

▶ 各種機器のIoT接続への貢献③

ビデオコール端末 CTV-003



リモコン　　本体

■ 仕様/本体

モデル	CTV-003
通信方式	LTE(VoLTE)
ディスプレィ	8インチ　WXGA
タッチパネル	静電式マルチタッチパネル
リモコン	特小無線
サイズ	235(W)x 195(H) x 65(D)mm
電源	AC100～240V
重量	0.9kg
動作温度	0℃～40℃
付属品	スタンド、ACアダプター、操作ガイド、保証書、リモコン, ストラップ、SIMピン

顔の見える安心コミュニケーション

表情はもちろん、手振りなど助きも見える安心が、生活のさまざまなシーンを支えます。

いつでもどこでもつながりあえる便利さ

外出先、遠隔地、LTE回線のビデオコールならいつでも どこでも つながります。
バッテリーを搭載, 急な停電時でも安心。

子供やお年寄りにもやさしい操作性

タッチパネルでワンタッチ
リモコンでワンプッシュで誰にでもかんたん。
特定小電力無線通信の為 つながりやすい

タッチフォン

すぐにつながる、いつでも話せるかんたんビデオコール　<タッチフォン>

docomoの3G回線が3月をもって停波します。
3G回線を利用したビデオコール端末CTV-001/CTV-002は利用できなくなります。
今後も利用できる LTE回線網対応のCTV-003を市場導入開始しました。

人手不足や業務負担の軽減といった訪問介護現場、在宅介護現場の課題解決に貢献するソリューションなどさまざまな活用シーンを提供します。

らくらく設置

回線工事不要で導入も簡単。
VESA規格に準拠: スタンド、モニターアーム、壁掛けなど設置に便利。

かんたん設定

タッチパネルによる簡単な操作で、各種設定を行うことができます。

シンプル操作

発信時も着信時もワンタッチで、誰にでも簡単に使えます。
自動着信機能でベッドにいても操作不要で通話を開始できます。

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

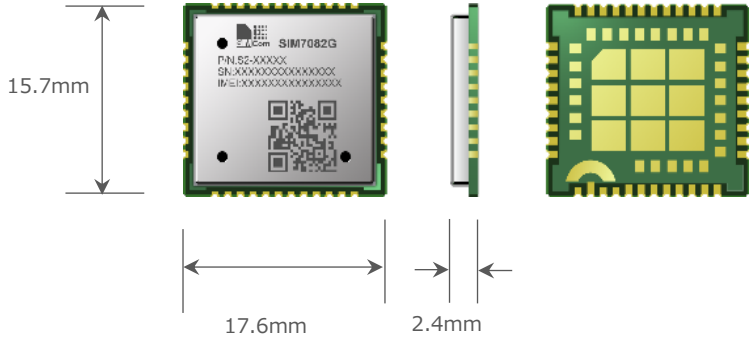
当社グループ技術のご紹介⑭

▶ 各種機器のIoT接続への貢献④

LTEモジュール販売開始　SIMCom SIM7082G (LPWA) / SIMCom A7681JP (Cat.1bis)

➢ LPWA通信モジュール **SIM7082G** 及びLTE Cat.1bis通信モジュール **A7681JP** を販売開始

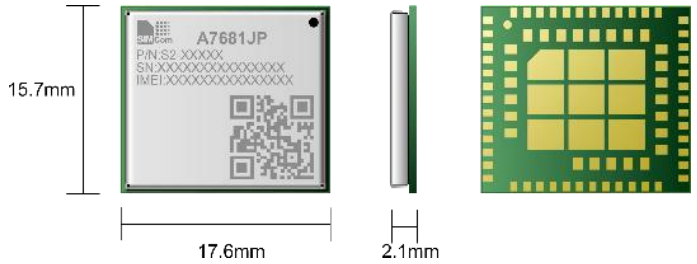
SIM7082G



SIM7082GはCat-M、Cat-NB、およびGNSSの無線通信モードに対応したLPWAモジュール
LCC+LGAフォームファクタを採用、17.6 mm × 15.7 mmというコンパクトなサイズ
小型製品の設計に最適

◆ 省電力モード（PSM）および拡張不連続受信（eDRX）により、SIM7082G シリーズは
バッテリー駆動システムでの利用において運用時間の長期化に効果を発揮します。

A7681JP



A7681JPは、LTE-FDDの無線通信モードに対応したLTE Cat.1bisモジュール
最大10Mbps DL/ 5Mbps UL 速度に対応
LGAフォームファクタを採用、コンパクトサイズでありながらIoTアプリに必要な機能を
搭載した高コストパフォーマンスを実現したモジュール

◆ UART、USB、I2C、GPIOなどの豊富なインターフェースを備え、強力な拡張性を有して
います。これにより、テレマティクス、監視装置、産業用ルーター、遠隔診断などの主要な
IoTアプリケーションに適しています。

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介⑮

THine Interface to the Future - Solution by Smart Connectivity -

▶ 各種機器のIoT接続への貢献⑤

PoEスイッチを販売開始　UPI-G-24V / SP1110-8PEGE2GF-I-DC / UP1110-8P-C-DC

UPI-G-24V

PoE 1ポート、
非PoE 1ポートを搭載



SP1110-8PGE2GF-I-DC

アンマネージドPoEスイッチ、
PoE 8ポート、光SFP2
ポート、
合計10ポートを搭載



UP1110-8P-C-DC

アンマネージドPoEスイッチ、PoE 8ポート、非PoE 2ポート、光SFP 2ポート
合計12ポートを搭載

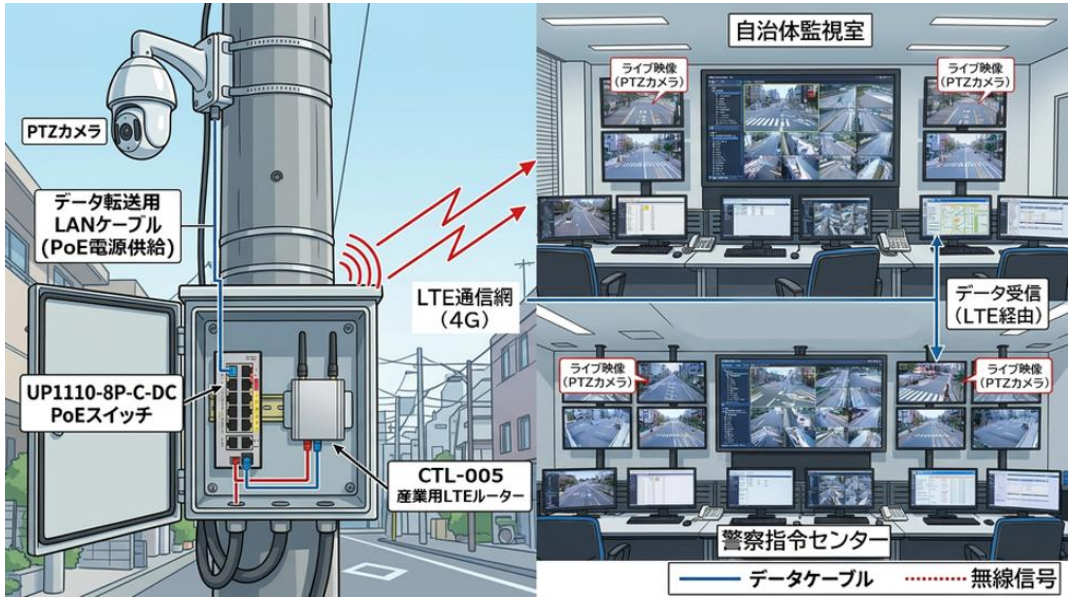


■ 製品概要

PoE(Power over Ethernet)とは、LANケーブル1本でデータ通信と電力供給を同時に行う技術で、IEEE 802.3af/at/bt (最大15.4W～90W)などの規格に基づき、IPカメラや無線AP、IP電話などに給電可能

各種ルーター機器との組み合わせで

- **スマート駐車場ネットワーク:** ナンバープレートの認識カメラと決済キオスクからの情報を駐車場管理センターへLTE回線で送信
- **太陽光発電システム:** ソーラーパネルアレイフィールドにおける PTZセキュリティーカメラからの映像と各種センサーからの情報を遠隔監視センターへLTE回線で送信する。
- **監視カメラシステム:** 電柱に設置したPTZカメラからの映像を,自治体の監視室や 警察の指令センターへLTE回線で送信する。



応用事例　CTL-005とPoEスイッチ[UP1110-8P-C-DCを利用した]監視カメラ映像の監視システム

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介⑯

- LSI,AIOTに次ぐ第3の事業の柱を確立、サーバー事業の立ち上げを加速

サーバー事業子会社「ザイン・ハイパーデータ株式会社」にて事業活動本格化

- 当社グループ連結子会社ザイン･ハイパーデータ㈱は、昨年度、米中問題に起因する当社グループ事業環境変化に鑑み、中国企業との合弁契約を解消し当社100%子会社化を実現。
- AIOT事業との親和性を活用し、日系企業･研究機関に対してサーバー事業を通じてAI等計算資源の活用への貢献を目指す。
- NVIDIA製GPU 搭載のAIサーバーを含む各種サーバー機器の中堅中小データセンター向け納入に向けて拡販中。

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

当社グループ技術のご紹介⑮

▶ SDGs目標への貢献（社会貢献）

Interface to the Future
- Solution by Smart Connectivity -
スマートに「つなぐ」ことにより、地球的負荷削減への貢献を目指します。



- ✓ DSPレス光半導体が、AI活用により膨大化するデータセンター消費電力について、AIサーバ内光伝送の消費電力の抜本削減に貢献
- ✓ V-by-One® HS plus Standard提供を通じた高精細ディスプレイの省電力化などによるエネルギー削減への貢献
- ✓ 車載センサー画像のスマート伝送への貢献
- ✓ 高速伝送技術によるケーブル本数削減への貢献
- ✓ 電源システム熱効率改善によるエネルギーの削減への貢献
- ✓ AI･IoT技術による人的・物的移動エネルギーの削減への貢献

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.

Interface to the Future
- Solution by Smart Connectivity -

URL https://www.thine.co.jp/corporate/investors/
【お問合せ先】
〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9-1
総務部IR担当 （TEL: 03-5217-6660）

本資料に記載されている見通しや業績予想などのうち、歴史的事実でないものは現在入手可能な情報から得た当社の経営陣の判断に基づき作成しております。実際の業績は、当社の事業領域を取り巻く国内および海外の経済・金融情勢等、様々な重要な要素により、これら業績見通しとは異なる結果となり得ることをご承知おきください。また、本資料に記載されている各企業名、製品名等は、それぞれの所有者の商標あるいは登録商標です。

Copyright © 2026 THine Electronics, Inc. All Rights Reserved.